

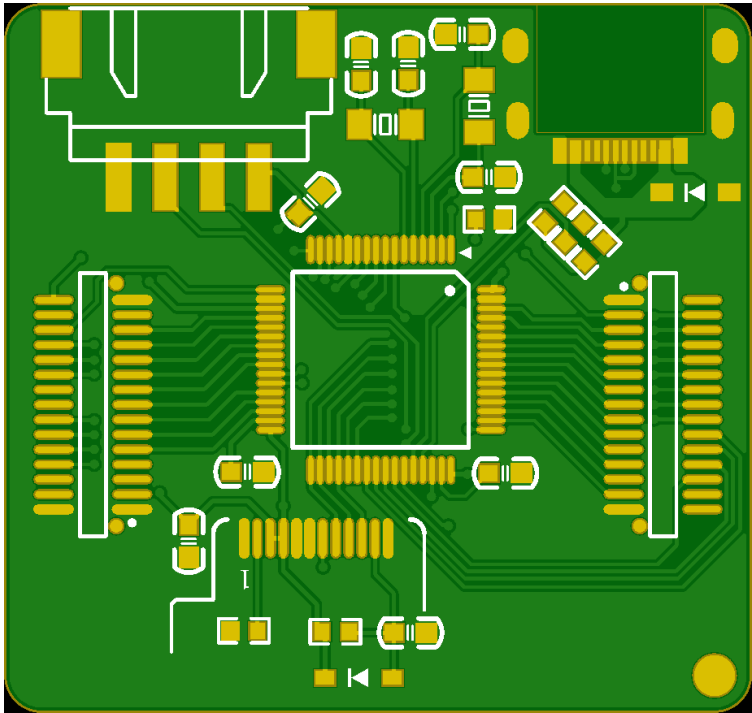
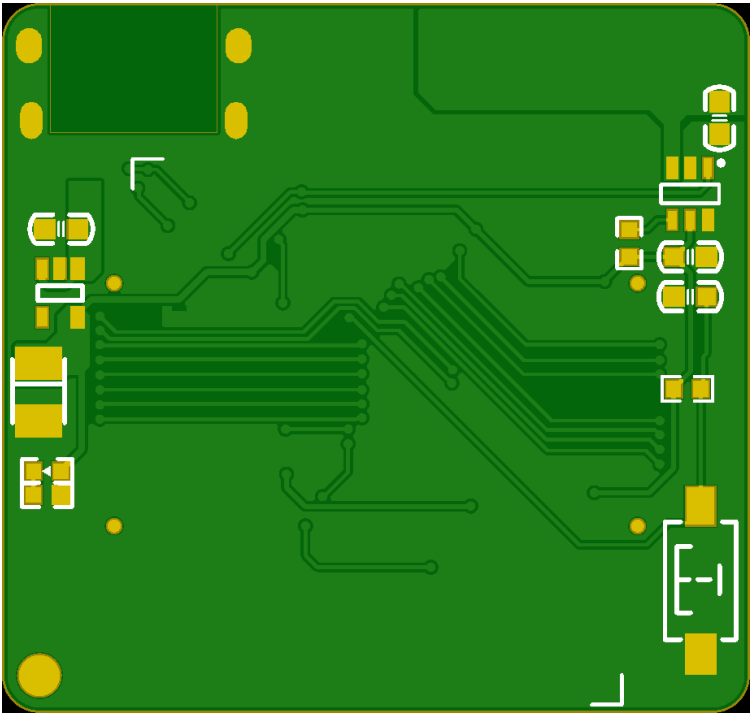


检查报告

时间2022-02-05

文件名：Project Outputs for MCU层数： 2

尺寸： 40.01*38.00 mm



警示项

报告项目	类型	分析结果	描述与建议
Mark点	Mark点	有	<p>用于贴片机对位的基准点叫Mark点，可校正坐标，并精准的定位到PCB板上对应元器件位置。</p> <p>焊盘直径1.0mm 阻焊窗口直径1.0mm</p> <p>您的设计中的Mark点数为 8个</p>
板边距离	铜/PAD/线到板边距离	板边异常	<p>外形（板框）用于机械成型，焊盘、铺铜及走线都应避开外形线，避免出现锣断线或露铜的情况。</p> <p>铜、焊盘、导线到板间距≥15mil</p> <p>您的“导线/焊盘/覆铜到板边”最小间距为11.06mil，成型时可能存在露铜隐患，建议“铜到板边”最小间距≥15mil</p>

板边距离	SMD到板边距离	板边异常	<div><div><div>SMD焊盘与板边距离过近，PCB成型时焊盘有损坏的风险，影响元件焊接的可靠性。</div><div><div></div><div></div></div><div>外形边线</div></div><div><div>您的“SMD焊盘到板边”最小间距为12.08mil，间距小于15.75mil，会影响焊盘的完整度，可能会导致焊锡不良，建议间距≥15.75mil</div></div></div>
------	----------	------	--

全部检查项

报告项目	类型	分析结果
电气信号	断头线	✔ 正常
	孤立铜	✔ 正常
	无效过孔	✔ 正常
	片式SMD没连线路	✔ 正常
	锐角	✔ 正常
最小线宽	最小线宽	✔ 正常 0.2032 mm
最小间距	线到线	✔ 正常 0.152126 mm
	盘到线	✔ 正常 0.152126 mm
	盘到盘	✔ 正常 0.152126 mm
最小焊盘	BGA焊盘	✔ 正常
	常规焊盘	✔ 正常
	长条焊盘	✔ 正常
SMD间距	同网络SMD焊盘间距	✔ 正常
	不同网络SMD焊盘间距	✔ 正常 0.199898 mm
	同器件焊盘间距	✔ 正常
	不同器件焊盘间距	✔ 正常
网格铺铜	网格线宽	✔ 正常
	网格线距	✔ 正常

孔大小	最小孔径	✔ 正常
	最大孔径	✔ 正常
	厚径比	✔ 正常
槽孔	最小槽宽	✔ 正常
	最大槽宽	✔ 正常
	槽长宽比	✔ 正常
孔环	过孔孔环	✔ 正常
	插件孔孔环	✔ 正常
孔到孔	同网络过孔	✔ 正常
	不同网络过孔	✔ 正常
	插件孔	✔ 正常
孔到线	过孔到表层	✔ 正常
	插件孔到表层	✔ 正常
	过孔到内层	✔ 正常
	插件孔到内层	✔ 正常
	NPTH到铜	✔ 正常
板边距离	铜/PAD/线到板边距离	❗ 187pis 板边异常
	SMD到板边距离	❗ 18pis 板边异常
	孔到板边	✔ 正常
特殊孔	半孔	✔ 正常
	盲埋孔	✔ 正常
	盲埋孔距离	✔ 正常
	激光孔	✔ 正常
	正/长方形孔	✔ 正常

焊盘规格	焊盘大小异常	✔ 正常
	封装内间距异常	✔ 正常
孔上焊盘	盘中孔	✔ 正常
	插件孔	✔ 正常
	过孔上焊盘	✔ 正常
	非金属孔	✔ 正常
阻焊开窗	阻焊异常	✔ 正常
	阻焊盖线	✔ 正常
	阻焊间隙	✔ 正常
	同网络阻焊间隙	✔ 正常
	漏阻焊桥	✔ 正常
	同网络漏阻焊桥	✔ 正常
孔密度	孔密度	⚠ 0个; 0.00万/m²
沉金面积	沉金面积	⚠ 14.93%
飞针点数	飞针点数	⚠ 245
Mark点	Mark点	⚠ 8pis 有
锣长分析	锣长分析	⚠ 202.428m/m²